

<<电子产品结构工艺>>

图书基本信息

书名：<<电子产品结构工艺>>

13位ISBN编号：9787040108637

10位ISBN编号：7040108631

出版时间：2002-1

出版时间：高等教育出版社

作者：钟名湖 主编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子产品结构工艺>>

内容概要

本书是中等职业教育国家规划教材，根据2001年教育部颁布的中等职业学校重点建设专业（电子与信息技术专业）教学指导方案编写，同时参考了有关行业的职业技能鉴定规范及中级技术工人等级考核标准。

全书共分八章，包括基础知识、电子设备的防护设计（气候防护、热设计、减振缓冲和电磁屏蔽）、电子设备的元器件布局与装配、印制电路板的结构设计及制造工艺、电子设备的整机装配与调试、电子产品技术文件和计算机辅助工艺过程设计、电子产品的微型化结构和整机结构。

本书可作为中等职业学校电子信息类专业教材，也可作为相关行业岗位培训及工程技术人员参考。

<<电子产品结构工艺>>

书籍目录

第一章 基础知识 1.1 电子设备结构工艺 1.2 对电子设备的要求 *1.3 产品可靠性 *1.4 提高电子产品可靠性的方法 小结 习题第二章 电子设备的防护设计 2.1 电子设备的气候防护 2.2 电子设备的散热 2.3 电子设备的减振与缓冲 2.4 电磁干扰及其屏蔽 小结 习题第三章 电子设备的元器件布局与装配 3.1 元器件的布局原则 3.2 典型单元的组装与布局 3.3 布线与扎线工艺 3.4 组装结构工艺 3.5 电子设备连接方法及工艺 *3.6 表面安装技术 *3.7 微组装技术 小结 习题第四章 印制电路板的结构设计及制造工艺 4.1 印制电路板结构设计的一般原则 4.2 印制电路板的制造工艺及检测 4.3 印制电路板的组装工艺 *4.4 印制电路板的计算机辅助设计 (CAD) 过程简介 小结 习题第五章 电子设备的整机装配与调试 5.1 电子设备的整机装配 5.2 电子设备的整机调试 5.3 电子设备自动调试技术 5.4 电子设备结构性故障的检测及分析方法 小结 习题第六章 电子产品技术文件和计算机辅助工艺过程设计 6.1 概述 6.2 设计文件 6.3 工艺文件 *6.4 计算机辅助工艺过程设计 (CAPP) 小结 习题第七章 电子产品的微型化结构 7.1 微型化产品结构特点 7.2 微型化产品结构设计举例 小结 习题*第八章 电子设备的整机结构 8.1 机箱机柜的结构知识 8.2 电子设备的人机功能要求 小结 习题附录1 绝缘电线、电缆的型号和用途附录2 XC76型铝材散热器截面形状、尺寸和特性曲线附录3 叉指形散热器的形式、尺寸和特性曲线附录4 电子设备主要结构尺寸系列 (GB3047.1-82) 参考文献

<<电子产品结构工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>